

壹、致股東報告書

於民國 109 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

本公司 2019 年上半年在中美貿易戰造成的市場不確定性、記憶體產品的供過於求以及智慧型手機銷售的下滑等因素影響下，營收出現大幅下滑。所幸在下半年隨著記憶體產品庫存水位下降及需求持續暢旺下，記憶體及邏輯產品等各項業務明顯轉強，我們全年度營收及獲利的表現較上一年度僅呈現小幅衰退，優於半導體產業整體表現，也符合我們的預期。

展望 2020 年，受惠於人工智慧、5G 通訊、物聯網、智慧駕駛、高速運算……等先進科技的蓬勃發展，我們看好整體營收仍會持續的往正向發展，唯一不確定因素繫於新型冠狀病毒疫情的發展與區域性的貿易衝突。目前新型冠狀病毒在中國大陸似乎得到控制，供應鏈得以逐漸恢復，減輕對世界經濟負面的影響，但歐美疫情的爆發，封城鎖國的行動正對未來市場造成無法預測的影響。

不管局勢如何發展，我們承諾專注於先進封測技術的研究及發展的政策不會改變，我們將更積極的朝向「世界先進封測技術領先的廠商」的目標前進。未來我們將更加強投資於：

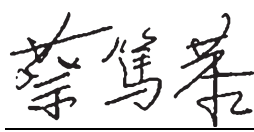
- 1.先進技術的研發及製造。
- 2.優秀人才的招募及培養。
- 3.與世界級的客戶及供應商建立親密的合作夥伴關係，一起成長。

過去我們的目標是成為世界最好的封測服務廠商之一，現在我們的目標是成為世界最好、世界第一的封測服務廠商，專注於品質、技術、服務。相信在 2021 年我們會看到過去多年的努力，開始引起世界的注目及肯定，我深深的期待 2025 年以前，力成能成為世界封測技術、製造的領導公司。

期望各位股東能繼續給予我們支持，力成全體員工將能更團結努力並持續創造佳績。

再次感謝各位股東女士、先生的支持與愛護！

祝 大家身體健康，萬事如意

董事長： 
蔡篤恭



力成科技股份有限公司
一〇八年度營業報告書

一、108 年度營業報告書

根據國際貨幣基金組織(International Monetary Fund) 109 年 1 月「世界經濟展望」報告指出，108 年全球經濟成長率為 2.9%，較 107 年下滑，為 97 年金融海嘯以來最疲弱的一年，主要原因來自於美中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，金融市場波動起伏甚大，但由於美國及歐洲等主要國家央行同步採取寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得資金行情發酵，不論股票、債券、不動產或是基礎建設等各項金融資產價格皆呈現上揚的局面。

在全球半導體的表現方面，根據國際研究暨顧問機構 Gartner 調查結果顯示，受到全球市場的不確定性使得總體經濟趨緩，及記憶體市場在 107 年下半年逐漸進入衰退期，導致 108 年記憶體營收較 107 年下滑 31.5%，總計 108 年全球半導體市場營收為 4,183 億美元，較 107 年減少 11.9%。在台灣半導體產業表現方面則明顯優於全球，工研院產科國際所於 109 年 2 月統計 108 年台灣 IC 產業產值達新台幣 26,656 億元(863 億美元)，較 107 年成長 1.7%，其中 IC 封裝業為新台幣 3,463 億元，較 107 年成長 0.5%，IC 測試業為新台幣 1,544 億元，較 107 年成長 4%。

雖然本公司於 108 年上半年因記憶體產業不佳而導致業績衰退，但下半年隨著記憶體庫存水位下降及需求持續暢旺下，包括終端產品、DRAM、Flash 及邏輯業務需求均顯著轉強，108 年全年度營收及獲利表現較上一年度僅呈現小幅衰退，尚符合我們的預期目標。未來我們仍將持續深耕技術、提供優良品質與服務、擴充產能以滿足客戶需求等方式來獲取客戶的信賴，透過集團資源整合等方式提高經營效率、降低成本並積極研發新技術、開發新產品線、投資新設備以及強化策略聯盟夥伴等方式，來增加公司的競爭力。

茲將 108 年度的營運成果報告如下：

(一)108 年度營業實施情形

本公司 108 年度合併營收為 665 億 2 仟 5 佰萬元，較 107 年度的 680 億 3 仟 9 佰萬元減少 2.23%；在盈餘方面，108 年度合併稅後純益歸屬於母公司股東的金額為新台幣 58 億 3 仟 8 佰萬元，較 107 年度淨利新台幣 62 億 3 仟 4 佰萬元減少 6.35%。

(二)財務收支情形

108 年度合併現金流量狀況：

a.營業活動之現金淨流入	17,955,080 仟元
b.投資活動之現金淨流出	8,064,186 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
c.籌資活動之現金淨流出	6,250,418 仟元
主要係配發股東現金股利及償還銀行借款	

(三)獲利能力分析

分析項目		年度	108 年度	107 年度
獲利能力	營業利益 / 實收資本比率		111.82%	125.57%
	稅前純益 / 實收資本比率		109.19%	121.10%
	資產報酬率		6.79%	7.67%
	股東權益報酬率		12.74%	14.62%
	純益率		8.78%	9.16%
	每股純益		7.52 元	8.02 元

(四)研究發展狀況

本公司持續專注於封裝技術及製程的開發，以滿足終端運用及客戶的需求。除了致力於 DRAM 及 NAND Flash 記憶體產品外，亦積極擴大邏輯及先進封裝產品與技術開發，在 Lead-Free Bump、Copper Pillar Bump、FCCSP、FCBGA、Hybrid CIS、SiP、3DIC(TSV)、BiO CSP(TSV)及 Automotive packaging 已進入量產多年；108 年度研究發展費用約為新台幣 19.05 億元，約占全年合併營收的 2.86%。未來研發中心將積極投資在 3DIC (TSV)、CIS CSP、Panel Level Fan-Out 及 Antenna in Package (AiP) 等技術，更建立射頻驗證實驗室(RF Lab)以滿足第五代行動通訊 (5G mobile)、物聯網 (IoT)、Automotive、Networking、HPC、AI 及 VR/AR 相關產品封測服務的主要提供者。

二、109 年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.重承諾(Promise)、創新技術(Technology)、提供整合(Integration)服務為公司的核心價值。
- 2.專注於半導體專業封裝及測試領域，與客戶、協力廠商共創利潤。
- 3.致力於先進技術的研發、適時的導入新產品，提高企業成長動能。
- 4.以穩定的品質、精湛的技术提供客戶全方位的服務。
- 5.整合資源、強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
- 6.培育人才、重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

(二)預期銷售數量

根據 WSTS (The World Semiconductor Trade Statistics) 預估，109 年全球半導體市場將開始出現復甦，預計銷售額可達 4,260 億美元，與 108 年相比，年增 4.8%。由工研院產科國際所的統計資料推估 109 年台灣 IC 產業產值約將成長 7%，顯示 109 年全球及台灣的半導體產業環境將可望較 108 年有所改善。

在 IC 產品類別部分，由 IC Insights 的統計資料顯示，108 年 DRAM 市場較 107 年下跌 38%，但依然是最大的 IC 產品類別，而 NAND Flash 市場則預計下跌 32%，DRAM 及 NAND Flash 合計佔 108 年全球 IC 產品市場總額的 29%。依據工研院產

科國際所的統計資料推估，109 年記憶體市場將逐步回溫，成長幅度約為 17%，高於半導體產業平均值，而 DRAM 及 NAND Flash 市場將分別成長 13% 及 32%，達到 708 億及 580 億美元。以終端應用 IC 而言，依 IC Insights 資料，通訊 IC 為佔比最高之類別，超過 36%，其次為電腦 IC 及消費性 IC。

受惠於 5G 及相關 AI 需求帶動，在終端產品部分，Gartner 預估 109 年全球個人電腦(PC)、平板和手機等裝置之出貨量可成長 0.8%，達到 21.6 億台。DIGITIMES Research 預估 109 年全球智慧型手機出貨量將成長 4.3%，回升到 14 億支；109 年全球資料中心市場規模預計將增加 10%，達到 2,062 億美元。

然而中美貿易狀況仍是影響全球經濟的最大不確定因素，中國是全球最大的半導體市場，其對於半導體產業供應鏈自主化的投入，有可能對全球半導體市場的供給與需求造成影響，這些風險因素將可能對現有廠商造成市場競爭的限制。

本公司在 DRAM、NAND Flash、Logic 及先進產品元件預計將有所成長。

109 年預期銷售數量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 125 億顆
測試	約 80 億顆
凸塊(Bumping)	約 90 萬片
晶圓測試	約 250 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SIP)	約 9,500 萬個

(三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)及直接出貨(Drop-shipment)的客戶服務以縮短交期及降低運送成本。
- 2.提升標準型 DRAM、Mobile DRAM、NAND Flash、UFS、Logic 等產品的比重。
- 3.持續 Logic 業務之拓展，並積極加速 Flip-Chip、SSD、Wafer level Packaging、晶圓級測試(CP)以及 Panel Level Fan-Out 的開發成長。
- 4.除了維持與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新產品的開發。
- 5.持續致力於成本控制，充分利用並整合集團資源，以提升公司競爭優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：

